

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡說明，請參閱「業務－戰略」一節。

[編纂]

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數）且[編纂]未獲行使，我們估計，經扣除[編纂]及[編纂]以及我們就[編纂]已付及應付的其他估計開支後，我們將收取[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元。我們擬按下文所載用途及金額動用該等[編纂]：

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於興建生產基地及建立新生產線以及採購生產相關設備，以提升我們的製造能力及滿足不斷增長的市場需求。根據弗若斯特沙利文的資料，全球及中國半導體封測市場於2024年分別達到人民幣6,494億元及人民幣2,481億元，並預計到2029年將分別增長至人民幣9,330億元及人民幣3,900億元。為應對採用我們產品的終端市場不斷增長的需求，我們計劃審慎高效地進一步擴充產能。具體而言：
 - (a) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於興建新生產設施及採購專業設備以進一步提升產能。我們主要根據我們服務的預計供需情況、該等服務當前及預計價格、現有生產設施的利用率及其擴張的可行性、估計開發成本以及資本資源制定生產擴充計劃。
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將會於未來五年用於購買擴充2.5D/3D及基板封裝能力所需的設備及機器。我們擬採用一套精巧的先進封裝與測試設備及機器，以確保我們生產業務的優質產出、高生產效率及製造安全標準。

具體而言：

- (A) 在2.5D/3D封裝方面，我們計劃採購高精芯片貼裝設備、高均勻度的全自動化學機械拋光(CMP)設備等，以促進大規模SoC-HBM互連、CPO光電互連、AP-WMCM的超大視場轉接板封裝以及高端CT光感等技術的開發。
- (B) 在基板封裝方面，我們計劃採購超大型模具清洗設備、高引腳數電性測試機等，以支持玻璃基IPD、射頻模組與相控陣以及高算力GPU封裝開發，以在極小尺寸下達成高可靠性、低延遲和高性能的系統級連接。

於往績記錄期間，在2.5D/3D封裝方面，我們的生產團主要使用基本芯片貼裝設備、CMP設備等；在基板封裝方面則主要使用基本模具清洗設備及電性測試機等。為應對更具創新性及可能更為複雜的設計和封裝需求，我們擬採購

未來計劃及[編纂]

該等設備的先進型號，有助於我們以較低成本、更高速度及更短的產品周轉時間製作更精確的產品原型，從而提升我們的整體封裝能力。因此，我們計劃採購下表所載的設備，估計成本乃基於我們從相關供應商取得的報價：

2.5D/3D封裝方面

設備	單位數量	單價 (百萬港元)
電鍍設備.....	[編纂]	[編纂]
模塑	[編纂]	[編纂]
濺射系統.....	[編纂]	[編纂]
LDI曝光	[編纂]	[編纂]
CMP	[編纂]	[編纂]
光刻機	[編纂]	[編纂]
TCB	[編纂]	[編纂]
熱脫膠設備.....	[編纂]	[編纂]
芯片貼裝.....	[編纂]	[編纂]
3D X射線	[編纂]	[編纂]
其他	[編纂]	[編纂] ⁽¹⁾

基板封裝方面

設備	單位數量	單價 (百萬港元)
研磨一體機.....	[編纂]	[編纂]
模塑機	[編纂]	[編纂]
蝕刻線	[編纂]	[編纂]
激光開槽機.....	[編纂]	[編纂]
切割機	[編纂]	[編纂]
全自動打線機.....	[編纂]	[編纂]
其他	[編纂]	[編纂] ⁽¹⁾

附註：

(1) 所有其他種類擬採購設備的平均單價區間。

- (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於未來五年內興建新生產基地及建立生產線。此舉主要涉及將於設計、建造及／或相關樓宇室內外裝修以及安裝通風及電力系統等配套設施過程中產生的材料成本及公用設施開支。我們計劃增加產能，以應對先進封裝市場的增長及先進封裝產品的日益普及。揚州生產基地已於2025年7月開始運營，另一個新生產基地將設於鄰近我們南京生產基地的位置（「新生產基地」），以提升我們封裝產品的產能。

董事認為，經考慮行業增長、歷史增長、我們相對於其他市場參與者的競爭優勢及預期客戶需求，新生產基地的設立及現有

未來計劃及[編纂]

生產廠房的機器升級由充足的需求提供支持。詳情請參閱「業務－盈利路徑－不斷提升產能，把握日漸增加的市場機會」。

下表載列我們建設樓宇及安裝配套設施的估計成本：

用途	估計成本 (百萬港元)
土建工程(1號廠房及場地開發)	[編纂]
建築設備安裝工程(包括電氣、排水、消防 系統、暖通空調及智能化系統)	[編纂]
外部工程(包括外部公用設施網絡、園林綠化、 道路及圍牆)	[編纂]
標識及導視系統	[編纂]
機電工程(包括公用設施裝置／發電站)	[編纂]
土建工程(2號廠房建設)	[編纂]
(b) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於升級及提升現有生產設施，以提高生產效率及產品質量，包括於未來五年更換及優化主要設備及生產線。	
(c) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於在未來五年根據我們的產能擴張計劃招聘製造人員，以支持我們擴大生產經營及實施我們的業務策略。	

我們預期：(i)客戶下達的訂單數目將隨著我們產能提升而增加；及(ii)市場對更高複雜度及更高功能性的產品需求將持續增長。為應對該等增長，董事認為有必要招聘具備豐富行業經驗的額外人員以負責製造營運。具體而言，我們擬加強製造團隊的人手配置，以確保我們的產能可按照擴產計劃有效提升。招聘具備相關年資經驗的製造人員，對於支持我們業務策略的落實、維持質量標準，以及應對預期增加的客戶訂單將至關重要。

下表載列我們擬招聘的製造人員的首選資歷、經驗及薪酬：

職位	數量	資歷及／或要求	估計 平均月薪 (千港元)
集成電路操作人員／ 技術員／團隊負責人	[編纂]	持有大專或以上學歷， 並於集成電路行業具備 相關運營經驗。	[編纂]

未來計劃及[編纂]

職位	數量	資歷及／或要求	估計 平均月薪 (千港元)
先進封裝操作人員／ 技術員／團隊負責人	[編纂]	持有大專或以上學歷， 並於先進封裝領域具備 相關運營經驗。	[編纂]

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於提升先進封裝技術的研發能力及提高我們於半導體封測行業的技術競爭力，特別是專注於推進CAPiC平台的封裝與測試技術，涵蓋LDFO、X-SiP、TXV及2.5D/3D集成。具體而言：

- (a) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於支付研發部門的薪金開支，包括於未來五年招募額外合資格研發及技術人員。截至2025年12月31日，我們的研發團隊由283名僱員組成，佔員工團隊約13.0%。為配合我們推出新技術及新產品的量產（例如FOCT-S、CPO及TMV、EMI屏蔽SiP及OLGA），我們計劃於未來五年進一步擴大及優化我們的研發團隊，招聘在2.5D/3D先進封裝解決方案、高精度光學傳感及高性能汽車電子方面擁有豐富經驗的研發人員，以加強我們的核心研發能力、提升創新能力及支持我們技術平台的持續發展，以便有效處理更高複雜度及更高功能性的產品訂單。

下表載列我們擬招聘的額外研發人員的首選資歷、經驗及薪酬：

職位	數量	資歷及／或要求	估計 平均月薪 (千港元)
研發工程.....	[編纂]	持有相關專業的本科或以上學歷及半導體行業經驗	[編纂]
研發設計.....	[編纂]	持有相關專業的本科或以上學歷及半導體行業經驗，並熟練使用CAD及Cadence等設計軟件	[編纂]
產品工程師.....	[編纂]	持有相關專業的本科或以上學歷及半導體行業經驗	[編纂]

未來計劃及[編纂]

職位	數量	資歷及／或要求	估計 平均月薪 (千港元)
制程工程師.....	[編纂]	持有相關專業的本科或以上學歷，以及電子行業自動化改進及凸塊工藝方面的經驗	[編纂]
其他	[編纂]	持有相關專業的本科或以上學歷及相關行業經驗	[編纂]

- (b) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將於未來五年用於加強研發基礎設施及採購相關設備、軟件及原材料，以支持我們不斷增長的業務需求。例如，我們計劃購買具備超大視場光刻機、可貼裝超大尺寸基板的倒裝晶片封裝設備，以及支援HBM的晶圓級熱壓接合設備，主要用於開發2.5D/3D產品（基於矽基嵌入式超大中介層）及超大型FC-BGA產品。

為應對更具創新性及可能更為複雜的設計及工程需求，我們擬採購具備超大視場的先進型號光刻機、可貼裝超大尺寸基板的倒裝芯片封裝設備，以及支援HBM的晶圓級熱壓接合設備，主要用於開發2.5D/3D產品（基於矽基嵌入式超大中介層）及超大型FC-BGA產品。此舉將有助於我們以較低成本、更高速度及更短的產品周轉時間製作更精確的產品原型，從而提升我們的整體研發能力。因此，我們擬為我們計劃招聘的額外研發人員配置下表所載設備，估計成本乃基於我們從相關供應商取得的報價：

額外軟件及設備	單位數量	估計成本 (百萬港元)
軟件：		
Cadence	[編纂]	[編纂]
Ansys	[編纂]	[編纂]
設備：		
3D X射線	[編纂]	[編纂]
熱脫膠設備	[編纂]	[編纂]
晶圓研磨機	[編纂]	[編纂]
貼片機	[編纂]	[編纂]
焊球放置機	[編纂]	[編纂]
清洗設備	[編纂]	[編纂]
倒裝芯片鍵合機	[編纂]	[編纂]
全自動固晶機	[編纂]	[編纂]
其他設備	[編纂]	[編纂]

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作提升我們的商業化能力及擴展我們客戶協作生態系統。我們計劃：

- (a) 於未來五年擴充我們的銷售及營銷、客戶服務及業務支援團隊。我們相信在中國招聘具備行業洞察力的人員將可提升顧客互動及服務能力，並擴大我們銷售網絡的地理覆蓋範圍。截至2025年12月31日，我們的銷售及營銷團隊有30名僱員，佔我們員工總數約1.3%。董事認為，鑒於目前的工作量，我們現有的銷售及營銷團隊人員無餘力承擔我們擴張計劃帶來的額外責任。因此，我們有必要增聘人手以便(i)從海外市場及中國市場獲得新客戶；(ii)對封裝產品的趨勢進行相關市場研究及接觸潛在新客戶；及(iii)應對產能擴大後新老客戶採購訂單的預期增加。

此外，我們擬在中國聘請善於使用社交媒體、電郵營銷、搜索引擎排名、線上展示廣告及企業博客等數字營銷渠道的銷售及營銷主管。中國團隊將專注於建立我們的品牌知名度及通過社交媒體、搜索引擎排名、線上展示廣告及企業博客等數字渠道推廣我們的自有品牌產品，以促進產品銷售。下表載列我們擬招聘的銷售及營銷人員的首選資歷、經驗及薪酬：

職位	數量	資歷及／或 要求	估計 平均月薪 (千港元)
業務工程師.....	[編纂]	持有微電子科學與工程、電子工程、集成電路設計及集成系統等相關領域的本科學歷，並理解半導體行業技術發展趨勢及具備相關行業工作經驗	[編纂]

未來計劃及[編纂]

職位	數量	資歷及／或 要求	估計 平均月薪 (千港元)
客戶服務.....	[編纂]	持有至少本科學歷，並 擁有半導體行業相關經 驗及客戶服務經驗	[編纂]

- (b) 提升我們的數字營銷及運營能力，以進一步提高我們對客戶的響應能力以及加強顧客互動和服務效率。

考慮到中國互聯網普及率提升、中國專業及工業數字平台的快速發展，以及智能手機及網上通訊工具的廣泛使用，董事認為，提升我們的數字營銷及營運能力，對於加強我們的客戶互動及提升服務效率至關重要。為加強我們的品牌形象並提升客戶互動，我們計劃透過微信等專業及行業聚焦平台擴展我們的數字營銷渠道，該等平台將使我們能夠發佈技術產品資訊、展示我們在封裝方面的創新成果，並提高於目標企業客戶中的品牌知名度。此外，我們擬製作中英文雙語數字內容（包括技術案例研究及產品演示視頻），以向潛在國內及國際客戶展示我們於先進封裝技術方面的專業能力，例如系統級封裝(SiP)、WLP及倒裝芯片解決方案。進一步而言，為提升營運反應速度，我們擬引入客戶關係管理系統，以精簡與主要客戶的溝通流程、跟蹤項目里程碑，並提升我們回應客戶查詢及技術支援需求的效率。我們亦將加強我們的網上服務平台，以就訂單狀態、封裝規格及交付時間表提供實時更新。預期該等措施將提升透明度、服務效率及整體客戶滿意度。透過該等舉措，我們旨在與客戶建立更緊密的數字接觸點，提高我們的服務交付效率，並鞏固我們作為具備快速反應能力及創新能力的半導體封裝合作夥伴的聲譽。

- (c) 在中國台灣及對半導體封測的需求有望增長的其他海外市場（韓國、日本、東南亞、美國及德國）擴大我們的銷售網絡及業務。我們認為，中國台灣具備完善的半導體供應鏈、強大的IC設計能力且世界領先的晶圓代工廠和OSAT公司集中，增長潛力巨大。於中國台灣建立更強大的據點不僅使我們與當地的IC設計公司及晶圓製造商的合作更為緊密，亦可加強我們與主要行業參與者的合作。

我們認為，中國台灣具備完善的半導體供應鏈、強大的IC設計能力且世界領先的晶圓代工廠和OSAT公司集中，增長潛力巨大。於中國台灣建立更強大的據點不僅使我們與當地的IC設計公司及晶圓製造商的合作更為緊密，亦可加強我們與主要行業參與者的合作。我們亦計劃

未來計劃及[編纂]

擴展我們於其他海外市場的銷售網絡及業務佈局，包括韓國、日本、東南亞、美國及德國。根據弗若斯特沙利文的資料，全球半導體封裝市場分佈於多個地區。於2024年，中國佔全球市場約38.2%，但其他地區合共佔市場總額的60%以上，包括中國台灣（約21.4%）、韓國（約12.7%）、東南亞（約10.5%）、美國（約7.0%）、日本（約2.5%）及德國（約1.8%）。我們認為，擴展中國以外的銷售網絡及業務範圍符合行業慣例，也是擴大客戶群和推動收入來源多樣化的重要一著。

為加深我們於中國台灣的本地市場滲透，我們計劃於主要半導體設計產業集群附近（即新竹及台北）設立辦事處及技術支援中心，以便與客戶直接互動並提供及時的技術支援。此外，我們擬招聘具備豐富行業知識的本地銷售人員，以提供即時諮詢並加強客戶關係。於區域層面，我們將擴展我們於亞洲的業務佈局，重點覆蓋韓國、日本及東南亞。在韓國及日本，我們的策略為與半導體設計公司建立業務關係，其終端客戶主要應用於存儲及邏輯晶片等下游領域，並憑藉我們的封裝專業能力支持其高性能產品線。在東南亞，我們計劃通過定期拜訪潛在客戶以拓展客戶基礎，從而提升市場對我們封裝及測試能力的認知度。同時，我們將積極參與區域性半導體行業交易會，以提升品牌曝光並把握新的業務機會。於全球層面，我們擬加強我們在美國及德國的業務拓展，該等市場匯聚眾多跨國半導體公司的總部。我們計劃與該等市場的潛在客戶設立聯絡辦事處及／或開展聯合研發項目，以展示我們對長期合作及創新的承諾。與此同時，我們將運用數碼營銷及客戶關係管理系統，與海外客戶保持持續互動，確保跨時區的回應速度及服務效率。該等措施將使我們能夠建立多元且具韌性的銷售網絡，並鞏固我們於半導體封裝及測試解決方案方面的市場地位。

於往績記錄期間，我們大部分收益來自中國客戶，突顯國內對半導體封測服務的強勁需求，但董事認為，擴張至中國台灣及韓國、日本、東南亞、美國及德國等其他海外市場具有戰略重要性。中國台灣先進的半導體生態系統提供與領先半導體設計公司合作的機會，海外地區匯聚對內存、邏輯、汽車及工業領域有大量需求的跨國公司，而東南亞則為正在崛起的發展迅速電子產品中心。進行國際擴張將使我們的客戶基礎多樣化、減低地理集中風險、拓寬收入來源及增強對市場波動及監管變化的抵禦能力，從而加強我們的品牌知名度及於先進封裝技術的競爭地位，並支持長期增長。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元預期將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。

未來計劃及[編纂]

實施計劃

為達成上述業務目標，本集團自[編纂]起至2030年12月31日止期間的實施計劃載列如下。[編纂]應注意，以下實施計劃乃根據本節下文「基準及假設」一段所述的基準及假設制定。該等基準及假設本質上受多種不確定性及不可預測因素的影響，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。因此，概無法保證本集團的業務計劃將按估計時間表實現，亦概無法保證我們的未來計劃能最終完成。

	[編纂]用途					佔[編纂] 概約百分比	由內部資源 及／或銀行或 其他融資撥付 (A-B， 一般營運資金 除外)
	截至12月31日止年度						
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		
擬定資本 開支(A)	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	[編纂](B)	
	B的 百分比	B的 百分比	B的 百分比	B的 百分比	B的 百分比	百萬港元	百萬港元
興建生產基地及建立新生產線以及採購生產相關設備， 以提升我們的製造能力							
(a) 興建新生產設施及採購專業設備以進一步提升產能	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(i) 購買擴充2.5D/3D及基板封裝能力所需的設備及機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(ii) 興建新生產基地及建立生產線，主要涉及將於設計、建造及／或 相關樓宇室內外裝修以及安裝通風及電力系統等配套設施過程中 產生的材料成本及公用設施開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(b) 升級及提升現有生產設施，以提高生產效率及產品質量，包括更換及 優化主要設備及生產線	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(c) 用於根據我們的產能擴張計劃招聘製造人員，以支持我們擴大生產經 營及實施我們的業務策略	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及[編纂]

	[編纂]用途					由內部資源 及／或銀行或 其他融資撥付 (A-B， 一般營運資金 除外)
	截至12月31日止年度					
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	佔[編纂] 總額百分比
擬定資本 開支(A)	B的 百分比	B的 百分比	B的 百分比	B的 百分比	B的 百分比	[編纂](B)
	百萬港元					百萬港元
(a) 用於支付研發部門的薪金開支，包括招募額外合資格研發及技術人 員	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(b) 用於加強研發基礎設施及採購相關設備、軟件及原材料，以支持我們 於未來五年不斷增長的業務需求	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提升我們的商業化能力及擴展我們客戶協作生態系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金及其他一般公司用途 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

(1) 一般營運資金並不構成我們實施計劃所需總額的一部分。

未來計劃及[編纂]

基準及假設

董事已採用下列主要假設以編製截至2030年12月31日止期間的實施計劃：(a)本集團將擁有足夠的財務資源，以滿足未來計劃相關期間內的計劃資本開支及業務發展需求；(b)中國或本集團任何成員公司經營業務或將經營業務的任何其他地方的現有政治、法律、財政、社會或經濟狀況將不會發生重大變動；(c)本集團於本文件所述的各項未來計劃所需資金與董事估計的金額相比將不會發生重大變動；(d)與本集團相關的現行法律法規或其他政府政策，或本集團經營所在地的政治、經濟或市場狀況將不會發生重大變動；及(e)本集團已獲得的執照、許可證及資格的有效性將不會發生變動。

倘[編纂]定為高於或低於本文件所述[編纂]範圍中位數的水平，則上述[編纂]分配將按比例調整。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的上限），假設[編纂]未獲行使，則我們將收取額外[編纂]約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的下限），假設[編纂]未獲行使，則我們收取的[編纂]將約為[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），經扣除[編纂]及[編纂]以及我們就[編纂]已付及應付的其他估計開支後，我們將收取的[編纂]將為[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲行使，則因任何[編纂]獲行使而收取的額外[編纂]將相應按比例用於上述用途。

倘[編纂][編纂]並非即時用於上述用途，在適用法律法規允許的情況下，我們會將[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）或其他司法權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。在此情況下，倘上述[編纂]出現任何變動，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定，並刊發適當公告。